

$\text{NH-Si}(\text{CH}_3)_3$ ，其功能為將晶圓表面轉變為疏水性（圖5.6），增加光阻和晶圓表面的附著力，較常見的塗佈方式有液態塗佈（圖5.7）及蒸氣塗佈（圖5.8）兩種。液態塗佈為將HMDS液體直接噴灑於晶圓表面，利用旋轉之方式，將HMDS均勻分佈在晶圓上；蒸氣塗佈為將HMDS氣化，以氣體方式塗佈於晶圓表面，HMDS使用量較液態塗佈節省，且均勻性較佳，亦可避免由液態化學品夾帶其他物質所造成之污染。蒸氣塗佈為目前的主流，並可與去水烘烤之加熱平板整合於單一模組內，去水烘烤後即可進行HMDS塗佈。

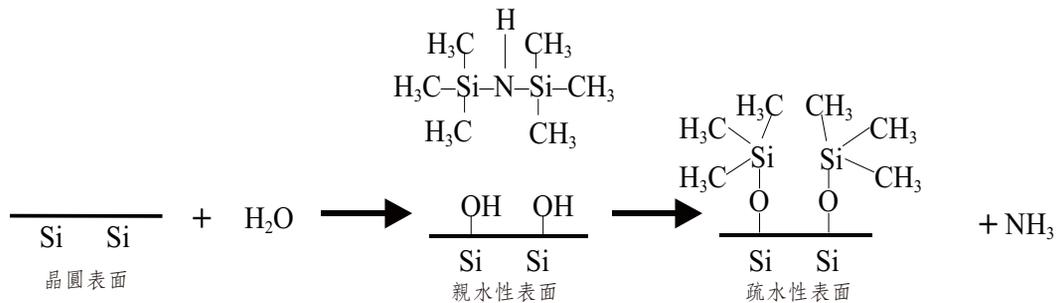


圖5.6 HMDS塗佈後之極性改變



圖5.7 HMDS液態塗佈